

证券代码：603061

证券简称：金海通

天津金海通半导体设备股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-012

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场访谈 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 线上分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 线上调研
参与单位名称	中邮证券、中信证券、海通证券、上海汐泰投资、招商证券、光大证券、国融基金、天风证券、理臻投资、长城财富保险资管、东北证券、华泰证券、东吴证券、仁馨资本、东兴证券、中泰证券、上海常春藤私募、上海慎知资管、华泰保兴基金、朋元资管、康曼德资本、平安银行、百川财富、盘京投资、中天汇富基金、大成基金、中海基金（以上排名不分先后）	
时间	2024年10月29日	
地点	进门财经	
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书刘海龙先生	
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、公司介绍主要内容</p> <p>金海通的主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售，客户群体涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM企业（半导体设计制造一体化厂商）、芯片设计公司等。公司产品在集成电路封测行业有较高的知名度和认可度，产品遍布中国大陆、中国台湾、欧美、东南亚等全球市场。</p> <p>公司自成立以来，始终坚持深耕集成电路测试分选机的研发、生</p>	

产和销售。公司深耕平移式测试分选机领域，产品根据可测试工位、测试环境等测试分选需求分为 EXCEED-6000 系列、EXCEED-8000 系列、EXCEED-9000 系列、SUMMIT 系列、COLLIE 系列、NEOCEED 系列等。

公司的核心技术集中于“高速运动姿态自适应控制技术”、“高兼容性上下料技术”、“高精度温控技术”、“芯片全周期流程监控技术”等领域。公司产品的软件定制化程度高，集成程度高，反馈速度快，技术支持响应度好；产品的 UPH（单位小时产出）、Jam rate（故障停机率）、可并行测试最大工位等指标已达到同类产品的国际先进水平。

二、公司 2024 年前三季度业绩情况介绍

2024 年前三季度，公司实现营业收入 2.56 亿元，较上年同期下降 4.59%，公司实现净利润 4,492.84 万元，较上年同期下降 14.78%。

2024 年第三季度，公司实现营业收入 7,319.42 万元，较上年同期下降 11.24%；2024 年第三季度，公司实现净利润 525.16 万元，较上年同期下降 32.33%，主要系营业收入下降、股份支付等费用增加所致。

2024 年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净流入 2,243 万元，较上年同期经营活动产生的现金流量净流出 8,365.99 万元有一定程度的改善。

截至 2024 年 9 月末，公司总资产为 14.98 亿元，较上年末下降 5.46%；净资产为 12.78 亿元，较上年末下降 8.64%。

三、调研问答

1、问：前三季度公司营业收入中产品结构是否有大的变化？

答：整体来看，公司今年前三季度营业收入中产品结构与以前年度没有特别大的变化。

2、问：公司产品研发和市场拓展的计划？

答：延续今年年初的计划，产品方面，公司将进一步跟进三温测试分选设备的定制化需求，持续加强针对新能源、电动汽车及 AI 运算等相关领域芯片测试分选的技术研发，继续加大对适用于 Memory、MEMS 及专用于先进封装产品的测试分选平台的研发力度。同时，公司也将积极布局重点关注的技术方向。市场方面，在积极开拓境内市场的同

	<p>时，公司将重点跟进境外头部 IDM、OSAT 以及设计公司等头部企业快速迭代的产品及测试分选需求，持续增强公司在境外市场的市占率及单个客户的渗透率。</p> <p>3、问：适用于 MEMS 的测试分选平台目前有怎样的规划？</p> <p>答：MEMS 相关产品类型很多，客户倾向定制化产品，单台机器价值较高。公司正与客户（设计公司）合作定制化开发，并进行技术积累。</p> <p>4、问：专用于先进封装产品的测试分选平台与其它产品有什么不同之处？</p> <p>答：采用先进封装技术的芯片产品在引脚数量、封装尺寸、散热功率等方面较使用传统封装技术的芯片都有更进一步的要求，这对测试分选机在测试精度、测试压力、测试稳定性以及热管理等方面提出更高的要求，甚至在某些特定的细分应用领域需要进行针对性地定制化开发。针对前述需求公司持续跟进研发，在现有产品系列的基础上进行迭代升级，满足客户在先进封装测试分选领域的需求。</p> <p>5、问：适用于 Memory 的测试分选平台的进展如何？</p> <p>答：公司正进行前瞻性研究及技术积累，基于部分客户的定制需求正在推进定制化项目开发。</p>
附件清单 (如有)	无
风险提示	以上如涉及公司所处行业发展趋势、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业发展、公司发展或业绩的预测和承诺，不构成公司或公司管理层对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
日期	2024 年 10 月 31 日